

=4

= 45 2003/0046809



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 44 704 A 1**

⑤1 Int. Cl. 7:
H 01 L 21/60

②1 Aktenzeichen: 101 44 704.3
②2 Anmeldetag: 11. 9. 2001
④3 Offenlegungstag: 27. 3. 2003

DE 101 44 704 A 1

⑦1 Anmelder:
Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

⑦4 Vertreter:
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler, 82049
Pullach

⑦2 Erfinder:
Mergenthaler, Egon, Dipl.-Phys., 91058 Erlangen,
DE

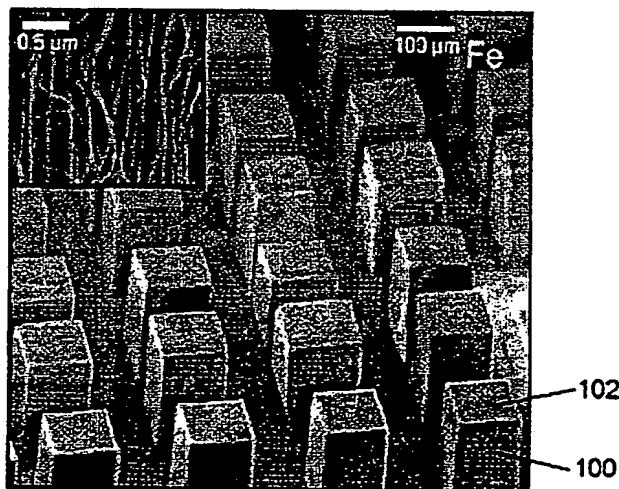
⑤6 Entgegenhaltungen:
DE 44 24 753 A1
US 58 18 700 A
EP 10 96 533 A1
WO 01 61 753 A1
WO 00 30 141 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Verfahren zum Verbinden eines Bauelements mit einem Träger und Anschlussfläche zur Herstellung einer Verbindung zwischen einem Bauelement und einem Träger

⑤7 Bei einem Verfahren zum Verbinden eines Bauelements mit einem Träger, bei dem das Bauelement zumindest einen ersten Anschlussbereich aufweist, und bei dem der Träger zumindest einen zweiten Anschlussbereich aufweist, werden zunächst elektrisch leitfähige, flexible Mikroteilchen (100) auf dem ersten Anschlussbereich und/oder auf dem zweiten Anschlussbereich erzeugt. Anschließend erfolgt eine Verbindung der Anschlussbereiche über die elektrisch leitfähigen, flexiblen Mikroteilchen.



DE 101 44 704 A 1

BEST AVAILABLE COPY